

동국대학교 양자기능반도체연구센터 소개

강태원

동국대학교 양자기능반도체 연구센터(Quantum-Functional Semiconductor Research Center; QSRC)는 1981년에 처음 실험실을 개설 하였다. 1982년도에 OECF 차관 자금으로 Auger Electron Spectroscopy(AES)와 Secondary Ion Mass Spectroscopy(SIMS) 및 Molecular Beam Epitaxy(MBE) 장치가 함께 붙어 있는 장비를 RIBER 사로부터 도입하고부터 동국대학교에서 반도체 연구가 시작되었다. 이 장비로 GaAs epi layer 성장과 양자 구조에 관한 연구를 수행 하였다. 10년쯤 지난 1992년도에 개인돈과 학교 재단에서 준 특별 지원금을 합쳐서 두번째 MBE 장비(RIBER Model 2300)를 살 수 있었고 이 MBE 장비로는 국방과학연구소로부터 적외선 열상 장치에 관한 연구 중 하나인 HgCdTe(MCT) epi layer 연구를 할 수 있게 되었다. 세번째 MBE는 1998년에 역시 RIBER사의 Compact 21을 구매하였고 이 MBE로는 GaN epi layer 성장연구를 수행하였다.

그후 1999년 과학기술부(MOST)와 한국과학재단(KOSEF)으로 부터 우수연구센터(Science Research Center: SRC)로 선정되었고 이때 연구비는 연간 약 10억 원씩 9년간을 지원 받았다. 2006년도에는 전체 한국인들이 Applied Physics Letter(APL)지에 한 해 동안 게재한 논문의 약 10% 정도를 우리 QSRC에서 소속 되어 있는 연구자들이 게재를 하였고 Advanced Material 2편, APL 표지에 2번 게재되기도 하였다. 이 기간 동안 미공군연구소 아시아 지역분소(AOARD)에서 연간 \$30,000씩 3년간 연구비를 지

원받았고 미국 Florida에 있는 중소기업 NovaKor사로부터 2008년 1년간 \$100만불을 지원 받았다.

SRC가 종료되고 나서 학교에서 중전처럼 전폭적인 지원도 받을 수 없을 뿐만 아니라 대외적으로도 경쟁력이 약해 질것이라고 판단하여 ERC(소장: 이진구 교수)와 상의하여 Nano 연구가 주인 SRC와 Information 연구가 주인 ERC 및 RF-ID System 연구가 주인 u-SCM이 행정적으로 통합하여 기초물질 연구와 소자 및 응용연구 그리고 시스템 연구를 한꺼번에 한다면 대내외적으로 경쟁력이 있을것이란 판단하에 세 기관을 통합하여 Nano Information Technology of Academy(NITA) (나노정보과학기술원)이라는 기구를 신설하였고 여기에 대학원과정을 만들어서 연구 센터에서 연구외에 대학원생 교육 및 지도를 할 수 있게 하였다. 현재 QSRC 연구인력은 내국인 연구교수 8명, 외국인 연구교수 8명과 5명의 대학원생 그리고 2명의 직원 및 2명의 조교가 상주하고 있다. QSRC에서는 집적도가 커지면서 생기는 반도체 소자 크기 축소 의 한계 및 이때 나타나는 양자 현상을 이용하여 신기능 반도체 소자의 재료 및 구조의 연구를 진행중이다.

주요한 연구내용을 요약하면 다음과 같다.

- ▣ 강유전반도체와 비휘발성 메모리 소자 연구
강유전반도체(CdZnTe)를 이용하여 비휘발성 기억 소자를 제안하여 특허를 받았는데 2006년 우수 특

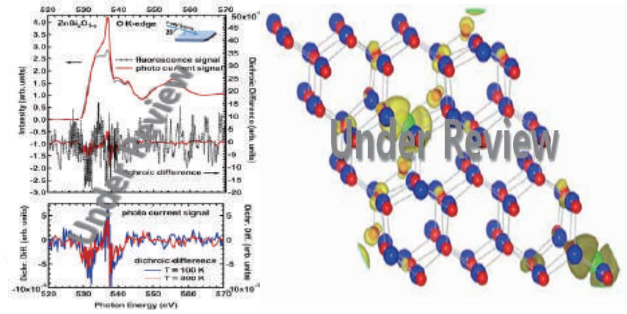


<저자 약력>

강태원 연구소장은 동국대학교에서 이학박사 학위를 받았으며, 박사후 동국대학교 교수, 부총장을 거쳐 현재 나노정보과학기술원 원장, 양자기능반도체연구센터 소장, 동국대학교 및 인도 힌두스탄대학의 석좌교수로 재직중이다. (twkang@dongguk.edu)



[Fig. 1] Europhysics News에 소개된 내용



[Fig. 2] 1ZnBiO1-x의 XAS와 XMCD 스펙트럼. 이론적으로 계산된 ZnBiO1-x의 spin charge density ($\rho^{\uparrow} - \rho^{\downarrow}$)

허로 선정되었다. 이 기술은 fatigue의 원인이 되는 것으로 알려진 oxygen vacancy를 제거했고 capacitor로 인한 시상수로 인해서 delay time 때문에 속도가 느린 것을 resistor를 사용함으로써 속도를 빠르게 했고 3단자 소자를 2단자 소자로 만들어 집적도를 더 높힐 수 있는 가능성을 보였다.

▣ 강자성반도체의 Curie 온도 상향
Spin을 한 방향으로 정렬시킨 반도체를 강자성반도체(Ferromagnetic Semiconductor; FMS 또는 Diluted Magnetic Semiconductor; DMS)라 하며 우리는 Quantum dot 이나 Nano rod로 만들면 Curie 온도를 상온 이상으로 올릴 수 있다는 것 알았다.

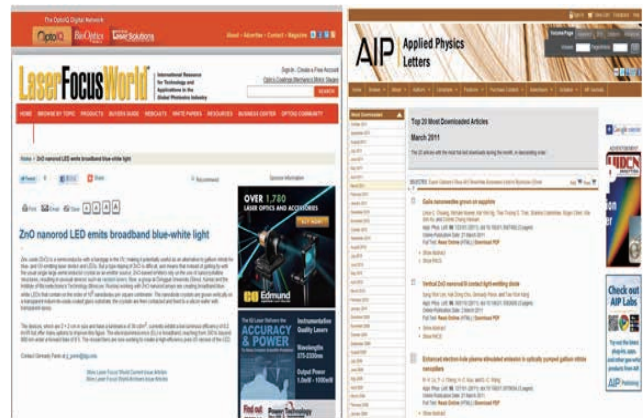
▣ 비자성 원소인 Bi를 도핑한 ZnBiO1-x 박막의 상온 이상에서의 강자성 및 강유전 특성 연구
ZnBi0.05O0.95 Bi 양을 3% 와 5%를 도핑한 결과 Bi가 3%의 경우 강자성 특성이 나타나고 5%일 때는 강유전 특성을 나타내었다. 이 결과는 Euro Physics News에 High Lights로 선정되었다

▣ 비자성 원소가 도핑된 ZnO의 상온 강자성 연구
이 연구에서는 Bi (Bismuth) 3, 5% 도핑한 상분리 없는 ZnO:Bi 박막을 PLD법으로 성장한 후, SQUID, XAS와 XMCD 측정 및 ab initio 이론 계산에 하여 성장된 ZnO:Bi 박막이 상온 상자성 특성을 가짐을 확인하였다. 이 결과는 2016년 1월 Nature Scientific Report 에 게재 되었다.

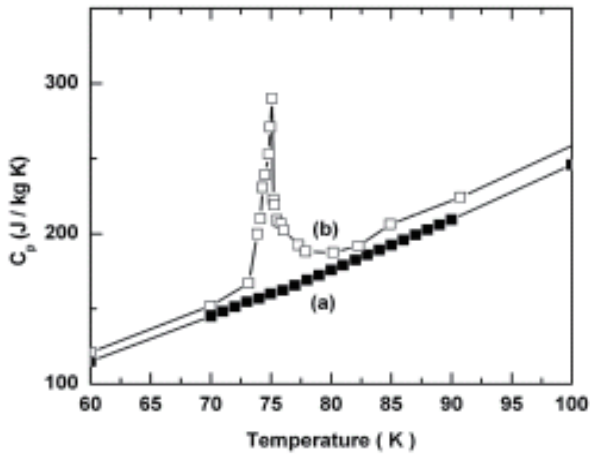
▣ 강자성반도체의 정밀한 전이온도 측정 방법 확립
희박자성반도체에 대해 새로운 전이온도 측정 기법으로 Magnetic Specific Heat Capacity (MSHC) 법을 제안하였다. 이 방법으로 강자성반도체의 전이온도를 정밀하게 측정 할 수 있게 되었다.

▣ New light source 개발
ITO가 코팅된 유리 기판 상에 n-ZnO 나노로드를 성장한 후 p+-Si 기판과 접촉을 하여 청색-백색 발광 다이오드(Vertical contact light emitting diode, VCLED)를 개발하였다. 이 결과는 2011년 3월 APL 다운로드 횟수에서 Top 7에 선정 되었고, 2011년 5월 Laser Focus World에 소개되었다.

▣ Graphene 성장 및 비휘발성 메모리 소자 제작
Reduced Graphene Oxide를 I-V 측정결과 비휘



[Fig. 3] (a) 2011년 5월 Laser Focus World에 소개된 (b) 2011년 3월 APL 다운로드 횟수에서 Top 7에 선정



[Fig. 4] ZnMnO 박막의 MSHC 특성 곡선

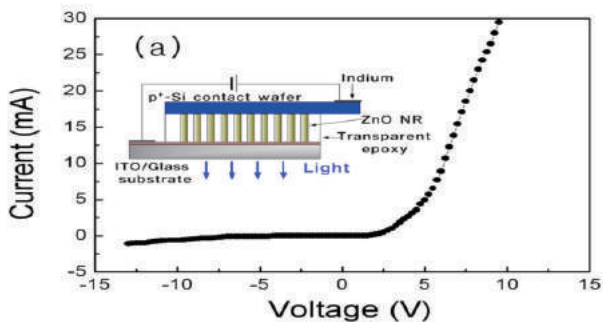
발성 메모리 특성을 얻었다.

■ 한편 현재 진행중인 연구는 다음과 같다.

- (1) Spin MEMRISTER
- (2) Multi Ferroic Semiconductor (MFES)
- (3) Dirac materials
- (4) van der Waals force contact superlattice
- (5) Frequency controlled full color display
- (6) 90% efficient solar cell
- (7) Energy from soil

■ 보유하고 있는 실험장비는 크게 3종류로 분류하는데 다음과 같다.

- (1) 성장장비 : DMS MBE, MOCVD, Graphene CVD, LPE, HVPE, PLD
- (2) 공정장비 : Class 1,000 clean room system,



[Fig. 5] VCLED의 구조도와 I-V 특성

E-beam litho., Mask aligner, E-beam evaporator, Evaporator I, II, III, and Nomarski SIMS, SEM, CL, EDX, and SQUID

(3) 분석장비 : PL, PR, DCRC, DLTS, AES, HRXRD, AFM, MFM, I-V, Sawyer tower, Hall effect system,



[Fig. 6] 1. DMS MBE 2. PLD 3. MOCVD 4. PECVD 5. HVPE 6. LPE 7. E-beam Lithographie system 8. HRSEM / EDAX / CL / EBIC 9. ICP-RIE 10. MASK ALIGNMENT & EXPOSURE SYSTEM 11. LED Wafer Prober Testing M/C 12. PL&PR 13. SQUID 14. SIMS 15. HRXRD 16. Hall effect system 17. Sawyer tower 18. MFM / AFM